

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	66	(US-4811081-\$ or US-5034245-\$ or US-5502889-\$ or US-5518964-\$ or US-5604379-\$ or US-5657104-\$ or US-5657206-\$ or US-5677576-\$ or US-5749997-\$ or US-5813870-\$ or US-5819406-\$ or US-5846853-\$ or US-5861661-\$ or US-5886415-\$ or US-5918113-\$ or US-5945729-\$ or US-5949142-\$ or US-5990563-\$ or US-6008072-\$ or US-6011315-\$ or US-6028365-\$ or US-6031590-\$ or US-6060782-\$ or US-6080931-\$ or US-6103553-\$ or US-6121688-\$).did. or (US-6133637-\$ or US-6137183-\$ or US-6140707-\$ or US-6147311-\$ or US-6175151-\$ or US-6194780-\$ or US-6204564-\$ or US-6228687-\$ or US-6239384-\$ or US-6262473-\$ or US-6284086-\$ or US-6285085-\$ or US-6307254-\$ or US-6323552-\$ or US-6335568-\$ or US-6355504-\$ or US-6356333-\$ or US-6383840-\$ or US-6409866-\$ or US-6410364-\$ or US-6410366-\$ or US-6414382-\$ or US-6417029-\$ or US-6420664-\$ or US-6429453-\$ or US-6448634-\$ or US-6458236-\$).did. or (US-6458609-\$ or US-6461890-\$ or US-6468830-\$ or US-6483718-\$ or US-6489687-\$ or US-6507095-\$ or US-6514560-\$ or US-6518091-\$ or US-6521483-\$ or US-6521995-\$ or US-6528343-\$ or US-6551918-\$ or US-RE38053-\$).did.	USPAT	OR	ON	2005/08/20 09:26

L2	130	(US-4811081-\$ or US-5034245-\$ or US-5502889-\$ or US-5518964-\$ or US-5604379-\$ or US-5657104-\$ or US-5657206-\$ or US-5677576-\$ or US-5749997-\$ or US-5813870-\$ or US-5819406-\$ or US-5846853-\$ or US-5861661-\$ or US-5886415-\$ or US-5918113-\$ or US-5945729-\$ or US-5949142-\$ or US-5990563-\$ or US-6008072-\$ or US-6011315-\$ or US-6028365-\$ or US-6031590-\$ or US-6060782-\$ or US-6080931-\$ or US-6103553-\$ or US-6121688-\$).did. or (US-6133637-\$ or US-6137183-\$ or US-6140707-\$ or US-6147311-\$ or US-6175151-\$ or US-6194780-\$ or US-6204564-\$ or US-6228687-\$ or US-6239384-\$ or US-6262473-\$ or US-6284086-\$ or US-6285085-\$ or US-6307254-\$ or US-6323552-\$ or US-6335568-\$ or US-6355504-\$ or US-6356333-\$ or US-6383840-\$ or US-6409866-\$ or US-6410364-\$ or US-6410366-\$ or US-6414382-\$ or US-6417029-\$ or US-6420664-\$ or US-6429453-\$ or US-6448634-\$ or US-6458236-\$).did. or (US-6458609-\$ or US-6461890-\$ or US-6468830-\$ or US-6483718-\$ or US-6489687-\$ or US-6507095-\$ or US-6514560-\$ or US-6518091-\$ or US-6521483-\$ or US-6521995-\$ or US-6528343-\$ or US-6551918-\$ or US-RE38053-\$).did.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 09:27
L3	70	2 and (filler particle (micro adj particle) microparticle)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:58
L4	57	("6133637").URPN.	USPAT	OR	ON	2005/08/20 11:30
L5	1	"6133637".pn. and etching	USPAT	OR	ON	2005/08/20 11:32
L6	38	2 and etching	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 11:35

L7	7	2 and ((chip die (semiconductor near1 (substrate device element))) with (etch\$3 polishing thinning))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 11:42
L8	956	((chip die (semiconductor near1 (substrate device element))) with (etch\$3 polishing thinning) with (reducing reduce reduced) with thickness)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 14:00
L9	29386	((chip adj1 chip) coc)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 11:43
L10	67	8 and 9	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 11:44
L11	4939	257/431-435.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:56
L12	1005	257/789-790.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:56
L13	875	438/48.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:56
L14	1367	438/127.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:57

L15	8031	11 12 13 14	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:57
L16	1	10 and 15	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:57
L17	1905744	(filler particle (micro adj particle) microparticle)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:59
L18	110	9 and 15 and 17	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 13:59
L19	110	18 and (chip die (semiconductor near1 (substrate device element)))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/20 14:02